欢迎参加**第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术研讨会，**参会代表请填写会议回执回传，并在5个工作日内打款至以下账户。参会代表请于**2025年8月20日**携带名片至会场签到并领取资料和参会证，会议及活动期间凭参会证进场，请务必随身佩戴。

**参会费用：**

2800元/人；半导体企业1500/人；学生1500/人；

费用包括：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用。（付款后开具增值税普通发票）

**付款账户**：

|  |  |
| --- | --- |
| 户名 | 山东中粉网信息技术有限公司  |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行 |
| 帐号 | 37050182640100001790 |

**—————— 会 议 回 执 ————————**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业全称（发票名称） |  |
| 通讯地址 |  |
| 参会意向（选填项） | □听会□采购（产品名称 ）□销售（产品名称 ）□其它合作需求：  |
| 参会代表姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 | E - MAIL |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 会务费用总额（不含住宿） | 元整 | ¥ |
| 如需预定会议酒店住宿请填此项（报到当天自行办理入住，住宿自费） | 是否预定住宿：□是 □否 | 住宿标准：□大床、348元/晚，（早餐58/位）□标间、348元/晚，（早餐58/位） |
| 会议酒店：**白金汉爵大酒店（苏州相城店）**□ 8月20日（全天报到） □ 8月21日（全天会议）  | 地址：苏州市相城区相城大道1111号 |
| **邮箱：d17568086987@163.com****联系人：段湾湾****联系方式：18610662668/13810445572** | 签字（盖章）： 日期： |